

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 8 月 5 日 (05.08.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/066697 A1

(51) 国際特許分類⁷: H05K 3/46, 1/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/016377

(22) 国際出願日: 2003 年 12 月 19 日 (19.12.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-11635 2003 年 1 月 20 日 (20.01.2003) JP
特願2003-294994 2003 年 8 月 19 日 (19.08.2003) JP
特願2003-309254 2003 年 9 月 1 日 (01.09.2003) JP
特願2003-342907 2003 年 10 月 1 日 (01.10.2003) JP

1 4 4 0 株式会社フジクラ 佐倉事業所内 Chiba (JP).
岸原 亮一 (KISHIHARA, Ryoichi) [JP/JP]; 〒285-8550
千葉県 佐倉市 六崎 1 4 4 0 株式会社フジクラ
佐倉事業所内 Chiba (JP). 中尾 知 (NAKAO, Osamu)
[JP/JP]; 〒285-8550 千葉県 佐倉市 六崎 1 4 4 0 株
式会社フジクラ 佐倉事業所内 Chiba (JP). 橋場 浩樹
(HASHIBA, Hiroki) [JP/JP]; 〒285-8550 千葉県 佐倉
市 六崎 1 4 4 0 株式会社フジクラ 佐倉事業所内
Chiba (JP). 岡本 誠裕 (OKAMOTO, Masahiro) [JP/JP];
〒285-8550 千葉県 佐倉市 六崎 1 4 4 0 株式会社フ
ジクラ 佐倉事業所内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒105-0001
東京都 港区 虎ノ門 1 丁目 2 番 3 号 虎ノ門第一ビル 9 階
Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, FI, US.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会
社フジクラ (FUJIKURA LTD.) [JP/JP]; 〒135-8512 東
京都 江東区 木場 1 丁目 5 番 1 号 Tokyo (JP).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

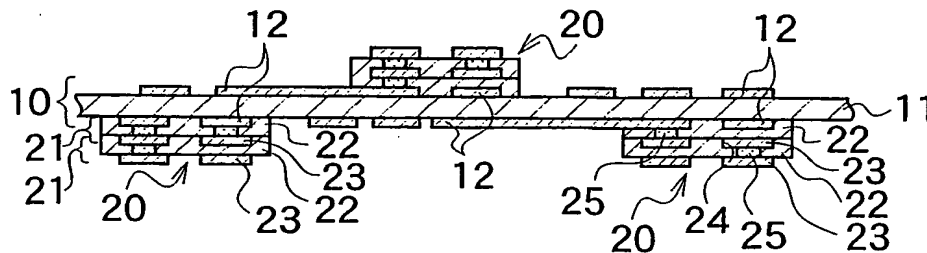
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊藤 彰二
(ITO, Shoji) [JP/JP]; 〒285-8550 千葉県 佐倉市 六崎

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MULTILAYER PRINTED WIRING BOARD AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 多層配線板およびその製造方法



(57) Abstract: A basic material (21) with at least one wiring circuit subjected to contouring previously is pasted to a mother board printed wiring board (10). The mother board printed wiring board (10) and the basic material (21) with a wiring circuit are connected electrically at at least one point through an inner via hole (24). The basic material (21) with a wiring circuit has a contour smaller than that of the mother board printed wiring board (10) and has an insular shape on the mother board printed wiring board (10).

(57) 要約: マザーボードプリント配線板 (10) に、予め外形加工がなされた少なくとも 1 枚の配線回路付き基材 (21) が貼り合わせされている。マザーボードプリント配線板 (10) と配線回路付き基材 (21) とが、少なくとも 1 箇所でインナビアホール (24) によって電氣的に接続されている。配線回路付き基材 (21) の外形はマザーボードプリント配線板 (10) の外形より小さく、配線回路付き基材 (21) がマザーボードプリント配線板 (10) 上で島状をなしている。

WO 2004/066697 A1